

# eMemory 2Q25 Earnings Call Q&A Transcript

August 15<sup>th</sup>, 2025, 16:00-17:00 Taiwan Time

## Q&A Transcript

---

### 1. 公司營運表現明顯不如 TSMC，請問原因為何？過往公司強調隨著製程技術往前開發，公司也發布 3nm 製程已經驗證完，是否能期待公司未來成長性能跟上 TSMC 甚至超過？

>>我們技術開展到權利金貢獻是非常長的週期，開發技術到製程驗證完成，至少 2 年，晶片客戶導入到量產權利金收取再 2 年，累積一定客戶使用量到比較顯著貢獻又需要幾年，但一旦製程導入後，所收取的權利金長達 20 年以上。以主要代工廠的製程驗證開發為例，我們從 2014 年開始 16nm 的技術開發，一直跟著代工廠完成 7/6/5/4 到現在 3nm 驗證完成，也已經有重要客戶導入，但 16nm 以下權利金的貢獻，現在才開始明顯。

我們分析過去 10 年與過去 5 年，我們與主要代工廠成長性的差異，不管是 10 年或者是 5 年，我們的晶圓出貨量成長超過主要代工廠約 10%，差異是在每片晶圓單價的成長。特別是在過去 5 年，主要晶圓代工廠的成長性加速是由更高單價的最先進製程成長驅動，今年以來，特別明顯。

這與我們的 IP，過去大都是先進製程穩定後，通過代工廠近 2 年的各項驗證，才會提供給客戶使用，這時能 catch 到的市場，通常是第二代或第三代的產品應用，再加上客戶產品本身驗證和量產時間，一般就需要長達 3~4 年的時間才有明顯的權利金貢獻。目前，這個現象，因為客戶對 security 的強勁需求，已經加速應用導入的速度。因為先進製程所收取的每片權利金是數倍於我們過去平均，加上額外的 PUF 相關 IP 權利金，我們未來成長，不僅是導入更多製程及應用類別所帶動的晶圓出貨量成長，還會加上每片權利金單價的成長。

### 2. 請問因為台幣趨穩，公司 Q2 匯損，第三季會不會有匯兌回沖？

>>第三季仍受到匯率影響，比如 7 月營收以美金計價成長 19%，台幣則是成長 7.3%。匯兌損益主要來自三方面：

1. 營收認列匯率差異：公司營收以美元計價，會於開立發票時依當時台幣匯率換算為新台幣認列營收。
2. 應收帳款兌現差異：實際收款日與原始認列日之間若匯率變動，會產生兌換差異。
3. 帳上美元資產之評價變動：結帳時的帳上美元資產需按期末匯率進行評價，產生 mark-to-market 所造成的匯兌損益。

本公司主要營運費用以新台幣支出，僅部分研發 Tool 及設備會以美元支付，因此並無美元負債部位。因為目前帳上美元評價資產約為 1,400 萬美元，實際影響仍須視匯率波動情形而定。

### 3. 連續第二季 tape out 數較去年同期下滑，是否有何特別原因？是在哪些應用與 process node？

>>第二季較去年同期少了 11 個 NTO，主要是來自於 DDI, PMIC, MCU 和 sensor 等消費性產品，這類產品的 tape out 數，並沒有常態性的 pattern，有時大客戶的一個 tape out 會比幾十個小客戶的 tape out 量產權利金貢獻大，也跟產業趨勢走向大恆大有關，但以 NTO 的製程節點來看，我們看到在 28nm 以下較先進製程的 NTO 數比例是提高，這與我們先進製程 process node 越往先進製程開發驗證完成有關，長期權利金 ASP 往

上趨勢是可以期待。隨著晶圓廠開發的 process node 越來越多，導入的應用晶片類別也越來越廣，tape out 數長期還是會在往上趨勢。

#### 4. 公司過去累積的 PUF 相關 tape out，何時才能看到權利金貢獻？

>> 過去幾年，我們已累積超過 110 個與 PUF 技術相關的 tape-out，導入的應用相當多，從最先進製程 processors 相關，車用 ADAS, 網通到一般消費型應用都有，涵蓋非常多元的客戶與不同製程平台。由於安全性 IP 的導入通常需經過較長的驗證與整合流程，實際量產貢獻權利金的時間相對 OTP 更長，但同樣，IP 的黏著性也更強。從 7 月的權利金報告，我們已經開始看到部分客戶應用已經量產，過去累計的設計定案，已經轉化成更穩定長期的權利金收入，加上目前客戶對 security IP 的需求相當強勁，預期授權金與權利金都會進入快速成長期。

#### 5. 傳言公司裁員減薪造成資本市場恐慌，是否公司營運出現問題？公司前幾年有多位管理層離職，是否有加入同業，變成競爭對手？

>> 3 位副總是自請退休，這是 1-2 年前的事，目前都是退休狀態，也沒有加入同業。公司營運沒有任何問題，反而客戶對我們 IP 的需求，遠遠超過目前的 RD 資源。

本次組織優化是為了提升營運效率並強化技術研發資源。自去年底到 8 月底止，公司人力從 360 人調整為 346 人，整體人數減少 14 人。當中，研發部門人力增加 6 人，非研發部門則減少 20 人，我們還在持續增加 RD，因應目前非常強勁的客戶需求，也引進 AI 演算法人才，把 AI 導入設計流程與管理系統，成果會是提升平均員工薪資。

#### 6. Caliptra 已經實施，請問公司是否看到因為 Caliptra 帶來的需求？

>> Caliptra Root of Trust 是由 OCP ( Open Compute Project ) 制定的一項規範，旨在建立以硬體為基礎的信任根架構，最初是為滿足資料中心平台的安全需求而設計。Caliptra 1.0 是去年 3 月 1 日公佈，的確有不少客戶因為 Caliptra 規範開始導入我們 IP，據客戶端的訊息，最快明年就會進入量產，會有權利金貢獻。今年 3 月 1 日公佈的 Caliptra 2.0 是包含 PQC ( 後量子加密 )，我們的 IP 也已經通過 NIST CAVP 的認證，也正在導入晶片客戶設計中。

#### 7. 與 ARM 的合作，有何進展？

>> 我們已加入 Arm Total Design (ATD) 計畫，並以 Security IP 支援 Arm Compute Subsystems (CSS) 的安全性，例如去年的 N3P 專案。我們預期今年下半年將有更多 3 奈米晶片導入，且合作將持續延伸至 2 奈米製程。

**8. 美國總統川普宣布輸美晶片、半導體課徵 100%關稅，若承諾在美設廠或正在設廠，則可豁免。請問對公司有何影響？**

>>我們的 IP 授權給全世界幾乎所有晶圓代工廠，從成熟製程到最先進製程。因為收取的授權金跟權利金是由晶片公司或晶圓廠直接支付，不涉及貨物的移動，跟關稅無關。至於客戶為了規避關稅選擇那裡生產，或者因為關稅產生的晶片成本或價格增加，則不是我們能掌握。如果導致晶圓代工價的變動，我們的權利金是按照代工價比例收取，這部分是會間接影響或受惠。

**9. 公司是否有跟美國 4 大 CSP 公司合作？**

>> 4 大 CSP 業者自己設計的晶片部分，已經是公司的客戶，從早期使用 OTP，到近期開始採用 PUF 相關 security IP，應用範圍也開始擴大。

**10. 中國晶片自主化，是否有中國相關 IP 業者會對公司產生影響？**

>>中國大量擴充晶圓代工廠產能，推動國產自製化，這部分造成晶圓代工價下跌，特別是去年，但因為我們的滲透率持續上升，使用我們 IP 的晶圓出貨量增加超過代工價下跌，整體權利金是持續成長。因為 IP 需要很長的導入期跟替換成本非常高，直接影響終端系統的可靠度，即使有小家做類似 IP 的公司，也有部分客戶去試用，但結果都是轉回來繼續用我們的 solution。

**11. 請問剛剛總經理提到的 RD capacity 不夠，是不是就沒辦法再接客戶的案子？如何解決這樣的問題？**

>> 上述 RD capacity 不夠，主要指的是在最先進製程 OTP 和 security IP 開發設計的部分，這部分需求非常強，因為成熟製程可以請客戶使用既有的 library IP，以減少提供客製化 IP。我們已經先調整內部 RD 的資源，像是調派部分 MTP 和 mature node OTP 的 RD 來做支援，同時，我們還是持續聘任新的 RD 人員來擴張我們 RD 的 capacity，同時進行設計流程改善，如導入 AI。